

华泰联合证券有限责任公司关于 苏州华太电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

作为苏州华太电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“华太电子”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”或“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

注册名称（中文）：苏州华太电子技术股份有限公司

注册名称（英文）： Suzhou Watech Electronics Co., Ltd.

注册资本： 38,473.6371 万元

法定代表人： 张耀辉

成立日期： 2010 年 3 月 16 日

住所和邮政编码： 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 10-1F

电话号码： 0512-85180000

传真号码： 0512-85180000

互联网网址：www.huatai-elec.com

电子信箱：board@huatai-elec.com

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书办公室

负责人：刘果容

联系电话：0512-88166888

（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平

1、发行人的主营业务

公司成立于 2010 年，是具备半导体产业链底层核心技术自主可控能力、实现产业链协同布局的平台型半导体企业。公司主要从事射频业务、功率业务相关产品的研发、生产与销售，产品可广泛应用于通信基站、半导体装备、卫星通信、服务器电源、光伏发电与储能、新能源汽车、工业控制、智能终端、AI 算力板卡等场景。公司历经十六年科研深耕、技术攻坚与产业沉淀，突破了传统半导体器件设计的底层桎梏，致力于半导体器件物理重大发现和半导体工艺技术突破，实现了半导体器件的原始创新设计，构建起兼具原创性与差异化竞争优势的技术体系和自主知识产权体系，核心产品性能达到国际领先水平，形成了难以复制和逾越的技术壁垒。公司拥有硅基 LDMOS 射频功放分立器件、RF LDMOS MMIC、GaN 射频功放分立器件与集成模组、碳化硅 RugSiC 功率器件与硅基超级结 IGBT 器件等原创核心技术，全面覆盖了半导体器件设计、集成电路设计、芯片应用方案开发、晶圆制造工艺、封装测试、封装与散热材料等多个关键环节，具备产业链一体化和自主可控优势。公司依托完善的底层技术体系，在半导体产业链中的多个应用领域取得了关键成果突破，已推出采用空腔封装的 LDMOS 及 GaN 射频功放分立器件、RF LDMOS MMIC、RugSiC 功率器件、超级结 IGBT 等多款产品，性能指标已达行业先进水平。

报告期内，公司的主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
射频业务	62,351.78	90.74%	57,652.47	87.63%	78,219.84	69.97%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
功率业务	2,861.30	4.16%	2,490.87	3.79%	8,575.32	7.67%
芯片工程定制业务	1,457.97	2.12%	5,223.85	7.94%	23,477.47	21.00%
IP 授权及技术开发服务	2,042.85	2.97%	423.75	0.64%	1,518.08	1.36%
总计	68,713.91	100.00%	65,790.94	100.00%	111,790.71	100.00%

公司的长期发展愿景为打造自主可控、高效可靠、具有差异化竞争力优势的半导体产品设计与制造交付平台，成为全球领先的大功率射频与功率半导体器件、芯片与解决方案供应商。公司聚焦“万物互联”和“新能源”两大国家重点支持的战略方向，通过提高通信系统效率和能源转换效率，助力国内龙头客户实现关键半导体芯片和器件的供应链安全，为国际知名客户提供性能领先的产品。在现有产品基础上，基于战略客户的需求牵引和自身技术积累，公司突破国外技术垄断，率先推出最大功率可达 3000 瓦的射频电源用射频功放芯片，解决国产半导体装备射频电源用大功率射频功放芯片的卡脖子问题，实现自主可控和技术赶超；同时，公司不断开拓新产品，已设计出新型氮化镓射频功放器件、新型碳化硅 RugSiC 功率器件、高性能 MCU 芯片、高精度电池管理芯片等新产品，实现产品间的战略协同，为客户提供一站式全套芯片解决方案。

公司高度重视研发投入以提高综合竞争优势，报告期内累计研发投入达 97,251.29 万元，占报告期累计营业收入的比例为 38.00%。公司已建立起一支高层次人才队伍，包括新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴获得者、江苏省双创人才等，截至报告期末，公司共有研发人员 293 人，占员工总数的 36.76%。自创立以来，公司作为课题责任单位参与了国家科技重大专项 02 专项等多项国家级研发任务，解决 5G、半导体装备的关键技术卡脖子问题，设立了江苏省射频功率芯片工程技术研究中心和江苏省企业技术中心，荣获国家级专精特新“重点小巨人”企业、国家专精特新小巨人企业、国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省独角兽企业、广东省专精特新中小企业、湖南省专精特新中小企业等荣誉称号，在多个产品领域形成了技术领先优势并建立了深厚的专利护城河。

2、发行人的核心技术

发行人针对行业和市场发展动态，结合客户需求，逐步探索并明确研发方向及产品演进路线，建立健全研发体系和研发管理制度，加强对研发组织管理和研发过程管理，不断强化包括半导体芯片设计、晶圆制造工艺、封装测试、高端散热材料研发及制造在内的完整技术架构，在核心技术方面屡获突破，树立了较高的技术门槛和显著的竞争优势。发行人各领域主要核心技术具体情况如下：

序号	核心技术分类	核心技术名称	对应产品或服务	对应专利	所应用的生产环节	所处阶段	技术来源
1	LDMOS 射频功率半导体器件设计与制造工艺技术	基于自对准硅化物和钨塞结构的 RF LDMOS 结构设计与制备工艺技术	射频功放芯片、IP 授权及技术开发服务	2011100881617 2014103956337 2022110594886 2020104063043 2020106239011 2020107078708 202010905406X 2020112428398 2020112593164 2020113162870 2020113368479 2023108365845 2024106291165	器件设计、制造工艺	大批量生产	自主研发
2		新型 RF LDMOS 栅结构设计技术				大批量生产	
3		RF LDMOS 自对准漏端场板结构设计技术				大批量生产	
4		RF LDMOS 器件及其制作技术				大批量生产	
5	LDMOS 及 GaN 射频功放芯片电路及单片集成设计技术	单片集成多路 Doherty 功放电路设计技术	射频功放芯片、IP 授权及技术开发服务	2020111300486 2020111300217 2021103227375 2021107473326 2021227253926 2021116053085 2022800009282 2022106404501 2022800039269 2022800039324 2022116253527 2022116704023 2024113288932	芯片设计	大批量生产	自主研发
6		宽带阻抗变换网络及 Doherty 功放电路设计技术				大批量生产	
7		射频大功率多路 Doherty 功放电路设计技术				大批量生产	
8		大功率 LDMOS-GaN 混合射频功放芯片设计技术				研发阶段	
9	射频控制芯片设计技术	多模式多通道高精度 MCU 用 ADC 设计技术	射频控制芯片	2022116760555 (在审) 2022116761948 (在审)	芯片设计	大批量生产	自主研发
10		多模式高速收发技术				大批量生产	
11	超高电压超大功率射频功率半导体器件设计与制造工艺技术	超高击穿电压 RF LDMOS 结构设计与工艺技术	射频功放芯片	2022116988449 2024107659831 2024109035334 2024109034505	器件设计、制造工艺	大批量生产	自主研发
12		超大功率射频功放芯片低热阻封装技术			封装	大批量生产	自主研发

序号	核心技术分类	核心技术名称	对应产品或服务	对应专利	所应用的生产环节	所处阶段	技术来源
13	碳化硅射频功放器件设计及工艺技术	高压碳化硅射频功放器件结构与工艺技术	射频功放芯片	2021216892466 2023110204235 2024106507009	器件设计、 制造工艺	研发阶段	自主研发
14	高性能低成本 GaN 射频功放器件设计与工艺技术	低成本衬底关键技术和工艺	射频功放芯片	2024119201631 2024119199434 2025110623435 2025115540119（在审） 2025105879899（在审）	器件设计、 制造工艺	研发阶段	自主研发
15		高性能外延关键技术和工艺					
16		低寄生互联器件结构和工艺					
17		高性能和高可靠复合场板技术					
18	功率 IGBT 设计及工艺技术	低关断损耗超级结 IGBT 设计技术	功率分立器件、技术开发服务	2020107078695 2021114086402 2021116385771 2022107800483 2022110791278 2022111036406 2022111028378 2022111036590 2022111675931 2022111669466 2023106397324 2023118258727 2024100572184 2024118646479	器件设计、 制造工艺	大批量生产	自主研发
19		高压超级结 IGBT 终端设计技术				大批量生产	
20	新型碳化硅功率器件设计及工艺技术	高鲁棒性 RugSiC 设计技术	功率分立器件	2024100976031 2024100976027 202411464767X 2024115001956 2024115555815 2025111207437 2025100674549 2025101041083	器件设计、 制造工艺	小批量生产	自主研发
21		高速高频开关能力 RugSiC 设计技术				小批量生产	自主研发
22		双芯片 RugSiC 集成设计技术				小批量生产	自主研发
23	功率模块封装技术	功率模块散热优化技术	功率模块	2021231690884 2022201922209	封装	小批量生产	自主研发

序号	核心技术分类	核心技术名称	对应产品或服务	对应专利	所应用的生产环节	所处阶段	技术来源
				2022116488306 2022100644732 2023114690853			
24	电源管理技术	快瞬态电源控制技术	模拟芯片、IP 授权及技术开发服务	2023115252146 2021231426970	器件设计	小批量生产	自主研发
25		大电流电荷泵的控制技术		2023116699570 (在审) 2024116766230 (在审)		大批量生产	
26	锂电池管理与智能高边开关保护技术	高精度锂电池管理保护技术		2021103227375 202110585599X 2021106787716 2021231426970 2022115825745 2023118256488 (在审) 2023118467258 (在审)	器件设计	大批量生产	自主研发
27		高边线束过热保护技术	大批量生产				
28	半导体器件建模、量产及测试技术	精确的半导体器件建模算法和流程技术	射频业务、功率业务	2019107627416 2020111153487 201911015092X 2021106787716	器件设计	大批量生产	自主研发
29		高良率工程量产技术			晶圆流片	大批量生产	
30		可靠性测试方案开发技术			测试	大批量生产	
31	高端散热材料结构及工艺技术	金刚石铜热沉制备工艺技术	高端散热材料、技术开发服务	202110779483X 2021107087190 2021107464948 2021111713676 2021114112375 2022107354285 2022110828003 2022116945481 2023117653502 202410636899X	高端散热材料生产制造	小批量生产	自主研发
32		多层金属界面键合工艺技术				大批量生产	
33		氮化硅陶瓷基板制备工艺技术				小批量生产	
34	射频大功率芯片空腔封装材料技术	封装材料间气密性结合技术	大功率射频封测业务、技术开发服务	2021107120150 2021115676093 2021101484365	封装	大批量生产	自主研发

序号	核心技术分类	核心技术名称	对应产品或服务	对应专利	所应用的生产环节	所处阶段	技术来源
35		具有预固化特性的高可靠性 胶粘剂技术		202210261075X 2021106728192 2022115362137		大批量生产	
36		纳米烧结银工艺技术				大批量生产	

3、发行人的研发水平

发行人是我国最早研发民用 LDMOS 大功率射频功放芯片的公司之一，是基站用射频功放芯片重要国产供应商，拥有小功率基站、mMIMO、大功率宏基站等射频功放完整解决方案，性能达到业界领先水平；公司更是全球少数可以量产 RF LDMOS MMIC PA 产品的供应商之一，已广泛用于宏基站和小基站领域。发行人是客户 A 的 5G 基站射频功放芯片核心供应商之一，也是爱立信、三星基站射频功放芯片重要供应商。从 2010 年开始，发行人基于国内晶圆代工厂工艺，从零到一研发出了用于移动通信基站的大功率硅基 RF LDMOS 半导体工艺；2015 年，发行人量产了用于 GSM 基站的大功率 RF LDMOS 产品并应用于客户 A 的基站中；2019 年，发行人量产了用于 5G mMIMO 的 RF LDMOS 产品；2020 年，发行人量产了用于 5G 小基站的 RF LDMOS MMIC PA 产品；2023 年，发行人量产了用于宏站驱动的 RF LDMOS MMIC PA 产品，成为全球少数量产该类芯片的供应商之一；2025 年，公司研发出新型氮化镓射频功放器件。目前发行人是国内唯一拥有自研工艺平台并商业化量产大功率基站用 RF LDMOS 产品的公司。

在半导体装备射频电源领域，公司依赖多年的技术积累与研发，于 2024 年率先研发出 3000 瓦超大功率射频功放芯片，并成功应用于客户 C 等半导体装备公司的射频电源。目前，公司是国内唯一能够量产 3000 瓦以上射频电源 RF LDMOS 产品的公司，技术指标已经实现了对国外竞争对手的超越，突破了国外的技术垄断。公司超大功率射频功放芯片产品广泛应用于等离子刻蚀机、离子注入机、等离子增强 ALD 等高端半导体装备，客户已覆盖客户 C、恒运昌、神州半导体、通快霍廷格等公司。同时，高端半导体装备迫切需要单管 4000 瓦或更大功率的射频功放芯片，公司作为客户 C 的战略合作伙伴，也是其半导体装备射频功放芯片的核心国产供应商，正为其研发用于半导体装备中射频电源的碳化硅超大功率射频功放芯片，为我国研制超大功率射频电源提供关键支撑。该产品可用于多种类型的半导体装备中，解决国产半导体装备射频电源用大功率射频功放芯片的卡脖子问题，实现自主可控和技术赶超。

封装技术是射频大功率芯片的核心关键技术之一。对于输出功率较低的射频功放芯片（如 20 瓦以下），通常可采用标准塑封工艺，其对封装技术的依赖相对

较低。然而随着射频功放技术往大功率、高频段应用场景的演进，塑封材料在散热、高频特性及可靠性方面难以满足高频、大功率射频应用的苛刻要求，因此传统的大功率射频功放芯片普遍采用陶瓷封装技术，该技术存在生产工艺链条长、生产效率偏低、成本高昂等固有不足，长期制约着相关芯片封装成品的产能提升与成本优化，成为产业发展的关键瓶颈。基于大功率射频功放芯片封装痛点，发行人攻克并规模化应用了新一代射频大功率空腔封装技术，并实现了相关高端散热材料自产。该技术相较于传统陶瓷封装，具备工艺链条短、生产效率高、综合成本低的显著优势。基于此技术及配套自产高端散热材料，发行人已建成射频大功率空腔封装生产基地，并已实现稳定规模量产与交付，解决了高端射频功放芯片封装的产能保障与供应链安全问题。目前，除满足公司自身芯片生产需求外，该产线已面向客户 A、中兴通讯等外部重要客户提供专业的射频大功率空腔封装测试服务并实现规模化量产，有力推动了我国射频大功率芯片产业链的自主化与整体发展。

发行人具备完备的高端半导体器件自主研发能力，是我国攻克射频通信领域核心芯片“卡脖子”技术的重要攻关力量。自成立以来，发行人承担并成功完成了多项国家级科技项目，包括：国家科技重大专项 02 专项“大功率射频 LDMOS 工艺研发”、国家发改委和工信部的技术攻关项目等。

此外，基于在大功率 RF LDMOS 领域长期积累的器件设计、物理建模等底层技术能力，发行人结合市场发展趋势，通过持续研发投入，成功将核心能力横向扩展至功率半导体领域。公司创新推出的 RugSiC 系列碳化硅功率器件，是基于半导体器件物理层面的原创性成果，该产品采用独特的无栅氧、正阈值 P-Gate 结构设计，有效规避了传统 SiC MOSFET 因栅氧可靠性问题所带来的技术挑战，且在部分关键性能指标上优于主流硅基 GaN 器件。RugSiC 器件可广泛应用于服务器电源、光伏储能发电、新能源汽车、工业控制、智能终端等高增长、高要求领域，市场前景广阔。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额（万元）	392,216.65	404,600.10	393,463.63
归属于母公司所有者权	248,570.44	249,608.69	274,704.00

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度
益（万元）			
资产负债率（母公司）	12.56%	9.36%	8.41%
营业收入（万元）	72,627.42	70,719.09	112,566.84
净利润（万元）	-12,797.92	-46,446.56	-18,401.57
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-3,972.58	-31,829.70	-17,577.48
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	-7,813.52	-38,108.82	-20,308.73
基本每股收益（元）	-0.10	-0.83	-0.46
稀释每股收益（元）	-0.10	-0.83	-0.46
加权平均净资产收益率	-1.60%	-12.14%	-6.92%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-8,729.30	-13,851.32	-11,789.62
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	40.28%	53.40%	26.85%

（四）发行人存在的主要风险

1、技术风险

（1）技术升级迭代风险

公司经过多年的持续研发投入，在射频业务、功率业务领域形成了一系列技术积累。随着行业技术的不断演进，技术革新及产品迭代加速、应用领域不断拓展已成为行业发展趋势。若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术上未能持续创新，亦或新产品技术指标无法达到预期，则可能会面临核心技术竞争力降低的风险，导致公司在市场竞争中处于劣势，面临市场份额降低的情况。尤其在通信基站末级射频功放芯片领域，若公司未来 GaN 射频功放芯片的研发迭代、客户认证及规模化销售进展不及预期，未能成功把握技术路线更迭带来的市场机遇，将面临现有产品市场份额被侵蚀的风险，可能对公司射频业务的长期成长性构成挑战。

（2）研发失败风险

半导体行业是技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大及行业技术更新速度快等特点。同时，下游通信基站、光伏发电与储能等领域客

户导入新产品需要经过性能、可靠性等多方面验证，供应商认证周期较长。若公司未能准确把握下游行业客户的应用需求，未能正确理解行业及相关核心技术的发展趋势，无法在新产品、新工艺等领域取得持续进步，可能导致公司产品研发失败。若公司新产品因稳定性差、应用难度大、成本高昂、与下游客户需求不匹配等因素无法顺利通过下游客户的产品导入和认证，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。

（3）关键技术人才流失风险

半导体行业属于技术密集型行业，对技术人员的依赖度较高，高素质技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。稳定的研发队伍和技术人员，是公司持续进行技术创新和保持市场竞争优势的重要因素，截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 293 人，占员工总数的 36.76%。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实、或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行等，将难以引进更多的高端技术人才，甚至导致现有骨干技术人员流失，将对公司生产经营产生不利影响。

2、财务风险

（1）尚未盈利及最近一期末存在累计未弥补亏损的风险

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为-17,577.48 万元、-31,829.70 万元和-3,972.58 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-20,308.73 万元、-38,108.82 万元和-7,813.52 万元，尚未实现盈利；截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-74,735.61 万元，存在累计未弥补亏损。

报告期内公司尚未盈利，主要原因系：（1）为完善产业链布局和提高市场竞争力，公司固定资产投资、期间费用较高，但同期收入规模尚小；（2）为实现产品迭代升级与拓展，公司研发投入较高，在研项目转化为收益需要一定周期；（3）公司为积累人才优势实施了较大规模的股权激励，股份支付费用较高；（4）因产业政策、规划变更，公司子公司苏州龙驰计提了较大金额的资产减值损失；因功率封测业务发展不及预期，公司对部分产线计提了较大金额的资产减值损失。

若公司未能进一步拓展业绩规模，或产品下游应用领域需求发生重大不利变

化，将可能导致公司收入无法按计划增长，无法及时扭亏为盈，有可能造成公司现金流紧张，对公司市场拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、战略性投入等方面造成不利影响。预计首次公开发行股票并上市后，公司短期内无法进行现金分红，将对股东的投资收益造成一定程度的不利影响。

(2) 大客户依赖风险

公司的主要产品应用领域为通信基站，下游行业集中度较高。受此影响，公司来自单一大客户的收入占比较高，报告期内，公司来自第一大客户客户 A（含指定采购商）的销售收入占营业收入的比例分别为 91.46%、79.31% 和 71.42%，存在大客户依赖风险。若因公司产品和服务质量不符合客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或客户未来因经营状况恶化导致对公司的直接订单需求大幅下滑，可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。

(3) 存货规模增加的风险

公司主要产品技术要求高、生产环节多、生产周期长，为保证能够及时满足客户需求，公司备有一定的安全库存。报告期各期末，公司存货余额分别为 24,415.40 万元、22,748.52 万元和 28,136.27 万元，随着公司经营规模的进一步扩大，公司存货账面余额有可能进一步增加。如果未来市场环境发生变化导致产品滞销积压，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，则有可能导致存货规模增加，并带来存货跌价的风险，进而对公司的业绩水平带来不利影响。

(4) 长期资产减值风险

报告期内，为形成各产品相互赋能的平台化竞争优势，提高对客户需求的覆盖能力，公司积极把握市场发展机遇、开拓业务领域，随着产能扩张和新业务布局，公司固定资产、在建工程、长期待摊费用等长期资产规模整体呈现增长趋势。2024 年，因产业政策变化，公司控股子公司苏州龙驰调整经营模式，导致前期为碳化硅器件生产所预留的部分设备闲置，经评估后公司对此计提资产减值损失 15,661.58 万元。此外，公司功率封测业务发展不及预期，经评估对相关资产计提减值损失 5,635.97 万元。如果未来公司碳化硅相关产品研发不及预期、封测业务未能改善，或公司不能有效拓展销售渠道，则有可能存在长期资产进一步减值的风险，进而对公司业绩带来不利影响。

3、内控与管理风险

(1) 公司实际控制人不当控制的风险

截至本上市保荐书签署日，公司实际控制人张耀辉直接及间接合计控制公司71.65%股份对应的表决权。尽管公司通过相关制度安排尽可能避免实际控制人操纵公司的现象发生，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司发展战略、经营决策、财务管理、人事安排等重大事项施加不利影响，可能导致其他股东的利益受到损害。

(2) 内控体系建设及内控制度执行的风险

公司已根据现代企业管理的要求，逐步建立健全了符合科创板上市公司要求的内部控制体系，但上述制度及体系的实施时间较短，且仍需根据公司业务的发展、内外环境的变化不断予以修正及完善。若公司因内控体系不能及时完善，或有关内部控制制度不能有效贯彻和落实，将可能影响公司生产经营活动的合规性以及运行效率，进而影响公司经营管理目标的实现。

(3) 经营规模扩张导致的管理风险

随着未来公司业务持续发展和本次募投项目的实施，公司的收入、资产规模预计将进一步扩大，员工人数也将相应增加，将对公司的经营管理、产品研发、质量管控、市场开拓和内部控制等方面提出更高的要求。如果公司的组织模式、管理制度和运营水平未能随业务规模扩大及时优化提升，将使公司一定程度上面临生产经营效率降低的管理风险，进而对公司的持续发展造成不利影响。

4、法律风险

(1) 知识产权风险

公司所处行业属于技术密集型行业，涉及专利、集成电路布图设计等知识产权，该等知识产权对公司持续经营具有重要意义。公司通过申请专利、与员工签署保密及竞业禁止相关协议等方式对自主知识产权进行保护，但未来不排除公司的知识产权受到不同形式的侵犯；同时，公司一贯重视自主知识产权的研发，避免侵犯他人知识产权，但不排除可能与其他竞争对手发生知识产权纠纷，目前公司与埃赋隆存在相关知识产权、技术秘密未决诉讼，若诉讼结果对公司不利，将

对公司生产经营产生不利影响。

(2) 技术授权风险

公司部分产品研发的过程中需要取得第三方 IP 授权，上述 IP 的供应商大部分集中在国外，且在全球市场具有一定的优势地位，如果国际政治经济局势、知识产权保护等发生意外或不可抗力因素，IP 供应商不对公司进行技术授权，则将对公司的经营产生不利影响。

(3) 房屋租赁风险

因跨地区开展业务的需要，公司及其子公司在苏州市、上海市、长沙市、深圳市、佛山市、江门市等多地租赁了房屋用作生产经营场所。租赁期限到期后，若上述房屋不能及时续租，公司及其子公司需重新选择经营场所并进行搬迁，可能短期内对经营的稳定性造成不利影响；公司承租的部分房屋未办理租赁备案登记，存在被所在地房地产主管部门处罚的风险。

二、申请上市股票的发行情况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股 (A 股)		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不低于 4,274.8500 万股 (不含采用超额配售选择权发行的股票数量)	占发行后总股本比例	不低于 10.00% (不含采用超额配售选择权发行的股票数量)
其中: 发行新股数量	不低于 4,274.8500 万股 (不含采用超额配售选择权发行的股票数量)	占发行后总股本比例	不低于 10.00% (不含采用超额配售选择权发行的股票数量)
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不低于 42,748.4871 万股 (不含采用超额配售选择权发行的股票数量)		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍 (按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算)		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍 (按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)		
发行方式	本次申请首次公开发行股票采用网下向询价对象询价配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式, 或者证券监管机构认可的其他发行方式		

发行对象	符合资格并在上海证券交易所科创板开户的投资者（国家法律法规禁止购买者除外），以及中国证监会、上海证券交易所发布的科创板相关规则规定的其他发行对象
承销方式	主承销商余额包销
募集资金总额	【】万元
募集资金净额	【】万元
募集资金投资项目	超大功率 LDMOS 功放器件、射频大功率氮化镓功放器件、大功率单片射频 LDMOS MMIC、高集成射频模组研发及应用项目
	全系列射频大功率封测设计和工程平台研发中心及产业化项目
	高性能功率芯片、配套芯片及应用方案的研发及应用项目
	研发中心建设项目
	补充流动资金
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发行手续费【】万元
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	【】
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排依法设立的另类投资子公司或实际控制本保荐人的证券公司依法设立的另类投资子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式

（一）保荐代表人

本次华太电子首次公开发行股票项目的保荐代表人为时锐和朱辉，其保荐业务执业情况如下：

时锐先生，作为保荐代表人负责了华兴源创、蓝特光学、富淼科技、长光华芯、双一科技、江苏新能、朗高科技首次公开发行项目；作为项目协办人参与了

金智科技非公开发行股票项目；作为项目主要成员参与了通灵珠宝、鹏鹞环保、国科微、大烨智能等首次公开发行项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

朱辉先生，作为保荐代表人负责了长光华芯首次公开发行项目、测绘股份向不特定对象发行可转债项目、三超新材向特定对象发行 A 股股票项目；作为项目组成员参与了中微公司、芯原股份、奕瑞科技等首次公开发行项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

本次华太电子首次公开发行股票项目的协办人为李文，其保荐业务执业情况如下：

李文女士，作为项目主要成员参与了长光华芯首次公开发行项目、先锋精科首次公开发行项目、朗高科技首次公开发行项目。

（三）其他项目组成员

其他参与本次华太电子首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：王镇、刘德巍、王渤菡、吴莎莎、张堇然、郭珂。

四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况说明

华泰联合证券作为发行人的上市保荐机构，截至本上市保荐书签署日：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其实际控制人、重要关联方股份的情况：

保荐机构将安排依法设立的另类投资子公司或实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司（以下简称“相关子公司”）参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。若相关子公司参与本次发行战略配售，相关子公司不参与询价过程并接受询价的最终结果，因此上述事项对本保荐机构及保荐代表人公正履行保荐职责不存在影响。

除此之外，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发

行人或其实际控制人、重要关联方股份的情况。

(二) 发行人或其实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

(三) 保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员，不存在持有发行人、实际控制人控制的其他企业及其他重要关联方股份，以及在发行人、实际控制人控制的其他企业以及其他重要关联方任职的情况；

(四) 保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

(五) 保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐机构承诺事项

(一) 保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

(二) 保荐机构同意推荐苏州华太电子技术股份有限公司在上海证券交易所科创板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

(三) 保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所对推荐证券上市的规定，自愿接受上海证券交易所的自律管理。

六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明

发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：

1、2026年2月26日，发行人召开了第二届董事会第二次会议，该次会议应到董事12名，实际出席本次会议12名，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》、《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性的议案》等议案。

2、2026年3月13日，发行人召开了2026年第一次临时股东大会，出席会

议股东代表持股总数 38,473.6371 万股，占发行人股本总额的 100%，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》、《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性的议案》等议案。

依据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规及发行人《公司章程》的规定，发行人申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市已履行了完备的内部决策程序。

七、保荐机构针对发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，及保荐机构的核查内容和核查过程的说明

（一）发行人符合科创板定位

1、发行人符合行业领域要求

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	根据《国民经济行业分类》，发行人所属行业为“C 制造业”中的大类“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	根据《战略性新兴产业分类》，公司主营业务属于“新一代信息技术产业（1）—电子核心产业（1.2）—新型电子元器件及设备制造（1.2.1）”、“新一代信息技术产业（1）—新兴软件和新型信息技术服务（1.3）—新型信息技术服务（1.3.4）”。
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于其中规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”，符合科创板的行业定位要求。
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

2、发行人符合科创属性要求

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》及《科创属性评价指引（试行）》，公司科创属性符合情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5% 以上，或最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023 年、2024 年及 2025 年，发行人累计研发费用为 97,251.29 万元，累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为 38.00%，超过 5%。
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 293 人，占员工总数的 36.76%，超过 10%。
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2025 年 12 月 31 日，发行人应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利共 121 项，超过 7 项。

最近三年营业收入复合增长率达到 25%， 或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2025 年，发行人实现营业收入 72,627.42 万元，超过 3 亿元。
--	---	---

（二）保荐机构的核查内容和核查过程

保荐机构就发行人是否符合科创板定位进行了如下核查：

1、实地查看了发行人生产设施及经营场所，查阅了发行人研发项目资料，走访发行人主要客户，取得并查阅了发行人商标、专利和所获荣誉，查阅同行业研究报告及同行业可比公司相关技术指标；

2、查阅了《战略性新兴产业分类》等政策文件，访谈发行人管理层及研发负责人，查阅了行业公开资料，了解了发行人业务及其所属行业领域，查阅了同行业可比公司的行业定位；

3、针对收入情况，项目组通过走访、函证、抽样、分析性程序等针对发行人收入真实性、增长情况等进行了核查；

4、针对研发投入，项目组查阅了发行人的研发流程，访谈发行人管理层及核心技术人员，了解发行人研发目标及研发方向；获取了会计师审计报告，抽查了发行人研发投入的归集情况，核查了发行人研发项目的资料；

5、针对研发人员，项目组取得发行人花名册、工资表及社保公积金缴纳明细，进行交叉比对复核，确定公司员工总人数；与公司相关人员访谈，查阅公司研发管理制度，了解公司研发工艺流程、研发活动涉及的相关部门及各部门所承担职责，确定研发人员数量；

6、针对发明专利，项目组获取并查阅了发行人专利登记证书，并进行了专利查档，确认相关知识产权的权属归属及剩余期限及有无权利受限或诉讼纠纷；了解生产流程中发明专利相关核心技术的运用。

八、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明

（一）发行人符合中国证监会规定的发行条件

1、本次公开发行符合《证券法》规定的发行条件

保荐机构根据《证券法》第十二条的有关规定，对发行人是否符合首次公开

发行新股的相关条件进行逐项核查，并确认如下：

(1) 发行人具备健全且运行良好的组织机构

保荐机构查阅了发行人现行有效的公司章程、内部组织结构图、相关管理制度和业务制度，并访谈了发行人相关人员。经核查，保荐机构认为发行人已经依法设立了股东会、董事会，并建立了独立董事、董事会秘书制度，聘请了高级管理人员，设置了若干职能部门，发行人具备健全且良好的组织机构。

(2) 发行人具有持续经营能力

保荐机构查阅了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天衡审字（2026）00945号）、报告期内公司缴税相关凭证、行业政策和研究报告，并访谈了发行人相关人员。经核查，保荐机构认为发行人具有持续经营能力。

(3) 发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

保荐机构查阅了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天衡审字（2026）00945号），并抽查了报告期内相关重点科目的会计凭证。经核查，保荐机构认为发行人最近三年的财务报告已被出具无保留意见审计报告。

(4) 发行人及其实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

保荐机构查阅了北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》、报告期内有关主管部门出具的合规证明，由实际控制人填写并签署基本情况调查问卷，并结合网络查询等手段核查了发行人及其实际控制人是否存在刑事犯罪或重大违法情况。经核查，保荐机构认为发行人及其实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

(5) 发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

保荐机构查阅了国务院证券监督管理机构关于企业公开发行证券的相关规定。经核查，保荐机构认为发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

综上，保荐机构认为发行人本次公开发行符合《证券法》规定的发行条件。

2、本次公开发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

保荐机构根据《首次公开发行股票注册管理办法》第十条至第十三条的规定，对发行人是否符合相关发行条件进行逐项核查，并确认如下：

(1) 发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

查证过程及事实依据如下：

保荐机构查阅了发行人设立时的营业执照、公司章程、发起人协议及其补充协议、股东大会会议文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件等资料。经核查，保荐机构认为发行人系苏州华太电子技术有限公司于 2022 年 8 月整体变更设立的股份有限公司，发行人的设立已履行了必要批准、审计、评估、验资、工商登记等程序。

同时，保荐机构查阅了发行人营业执照、工商登记资料、现行有效的公司章程、内部组织结构图、相关管理制度和业务制度等文件，并访谈了发行人相关人员。经核查，保荐机构认为发行人持续经营时间从有限公司成立之日起计算，持续经营已逾三年，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

(2) 发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告。

查证过程及事实依据如下：

保荐机构查阅了发行人会计政策、财务核算及财务管理制度、报告期内会计账簿与会计报表、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字（2026）00945 号）和《内部控制审计报告》（天衡专字（2026）00517 号），抽查了发行人报告期内相关重点科目的会计凭证，核查了

发行人各项内部控制制度的建立以及执行情况，并访谈了发行人相关财务人员。

经核查，保荐机构认为发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的审计报告；发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告。

(3) 发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

①资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

查证过程及事实依据如下：

保荐机构核查了发行人主要资产、专利、商标的权属情况、各机构的人员设置以及实际经营情况，核查了实际控制人及其控制的其他企业的基本情况，核查了发行人关联交易程序的合规性、定价的公允性、发生的合理性等情况。

经核查，保荐机构认为发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

②发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；受实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

查证过程及事实依据如下：

保荐机构查阅了发行人及其重要子公司的营业执照、公司章程、工商登记资料、历次董事会、监事会和股东大会会议文件，访谈了发行人的实际控制人、业务负责人，并获取了董事、高级管理人员及核心技术人员的简历。

经核查，保荐机构认为发行人的主营业务、管理团队和核心技术人员稳定；

发行人最近 2 年内主营业务一直为射频系列产品、功率系列产品、高端散热材料的研发、生产与销售及大功率封测服务，没有发生重大不利变化；发行人最近 2 年内董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；发行人控制权稳定，最近 2 年实际控制人始终为张耀辉，没有发生变更；发行人实际控制人及其支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

③发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

查证过程及事实依据如下：

保荐机构核查了发行人主要资产、专利、商标、集成电路布图设计专有权的权属情况并取得相关主管部门出具的专利、商标查册文件，获取了发行人及境内子公司的信用报告并对主要银行进行函证，结合网络查询、访谈相关当事人等手段核查确认发行人是否存在诉讼、仲裁等或有事项，并且研究了发行人所处行业的发展情况。

经核查，保荐机构认为发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

(4) 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

最近 3 年内，发行人及其实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

董事、曾任监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

查证过程及事实依据如下：

保荐机构查阅了发行人所属行业相关法律法规和国家产业政策，访谈了发行人高级管理人员，查阅了发行人生产经营所需的各项权利证书等，实地查看了发行人生产经营场所；同时，结合网络查询、访谈相关当事人等手段核查确认发行人及其实际控制人是否存在刑事犯罪或重大违法情况，核查确认发行人董事、曾任监事和高级管理人员是否存在被处罚的情况。

经核查，保荐机构认为发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；最近3年内，发行人及其实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人董事、曾任监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

综上，保荐机构认为发行人本次公开发行符合《管理办法》规定的发行条件。

（二）发行后股本总额不低于 3,000 万元

截至本上市保荐书签署日，公司股本总额为 38,473.6371 万元，发行后股本总额不低于 3,000 万元。综上，保荐机构认为，发行人符合上述规定。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上

本次公开发行后公司股本总额不低于 42,748.4871 万股，股本总额超过 4 亿元，公开发行股份的比例不低于 10.00%。综上，保荐机构认为，发行人符合上述规定。

（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准

根据《上市规则》，发行人不属于红筹企业且不具有表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：

1、预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元；

2、预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%；

3、预计市值不低于人民币 20 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元；

4、预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元；

5、预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

查证过程及事实依据如下：

保荐机构查阅了发行人的营业执照、公司章程及工商登记等资料，发行人系境内企业且不具有表决权差异安排，适用前述市值及财务指标标准；查阅了发行人历次股权变动涉及的协议文件、价款支付凭证等，并结合发行人目前盈利水平和同行业上市公司的市盈率等情况，对发行人的市值评估进行了分析；查阅了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天衡审字（2026）00945 号）。

经核查，发行人符合“预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”的标准。

综上，保荐机构认为发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

持续督导事项	具体安排
1、督促上市公司建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度	1、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求； 2、确保上市公司及其实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其各项义务； 3、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度； 4、持续关注上市公司对信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度的执行情况。

持续督导事项	具体安排
2、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见	1、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务充分了解； 2、关注主要原材料供应或者产品销售是否出现重大不利变化；关注核心技术人员稳定性；关注核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可情况；关注主要产品研发进展；关注核心竞争力的保持情况及其他竞争者的竞争情况； 3、关注实际控制人及其一致行动人所持上市公司股权被质押、冻结情况； 4、核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。
3、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照上市规则规定履行核查、信息披露等义务	1、通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项； 2、关注上市公司股票交易情况，若存在异常波动情况，督促上市公司按照交易所规定履行核查、信息披露等义务。
4、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	1、上市公司出现下列情形之一的，自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项； 2、就核查情况、提请上市公司及投资者关注的问题、本次现场核查结论等事项出具现场核查报告，并在现场核查结束后 15 个交易日内披露。
5、定期出具并披露持续督导跟踪报告	1、在上市公司年度报告、半年度报告披露之日起 15 个交易日内，披露持续督导跟踪报告； 2、上市公司未实现盈利、业绩由盈转亏、营业收入与上年同期相比下降 50% 以上或者其他主要财务指标异常的，在持续督导跟踪报告显著位置就上市公司是否存在重大风险发表结论性意见。
6、持续督导期限	在本次发行结束当年的剩余时间及以后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导

十、其他说明事项

无。

十一、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论

保荐机构华泰联合证券认为，苏州华太电子技术股份有限公司申请其股票上市符合《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华太电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人: 
李文

保荐代表人: 
时锐


朱辉

内核负责人: 
邵彦

保荐业务负责人: 
唐松华

法定代表人
(或授权代表): 
江禹

保荐人:

华泰联合证券有限责任公司

2022年5月6日

